

## CAE Molding Conference 2009 巡迴研討會 贊助活動

各位 業界先進您好：

台灣區電腦輔助成型交流協會與科盛科技合辦的「CAE Molding Conference 2009 巡迴研討會」將於 2009 年 8 月進行台灣區巡迴。此研討會為一大型且成功舉辦多年的巡迴研討會，今年將於 8 月 7 日在台北首場開跑，除了邀集國內外的領導廠商與學研界專家與會暢談之外，屆時必將吸引眾多廠商與會，盛況勢必可期。好的活動除了您的到場參與之外，更希望能有您的贊助支持，讓此研討會能更順利的進行。有您的熱情贊助除了給科盛一個機會，也給您一個提昇公司形象正面宣傳的好機會，期盼您的共襄盛舉。

### 贊助方案：

黃金級方案 (贊助費：NT\$ 5,000)	白金級方案 (贊助費：NT\$20,000)
將貴公司型錄放入活動資料袋中	將貴公司型錄放入活動資料袋中
將貴公司型錄放入研討會論文中	將貴公司型錄放入研討會論文中
於活動網頁中放置貴公司 Logo	於活動網頁中放置貴公司 Logo
	於廣宣電子報中放置貴公司 Logo <發送對象超過 5 萬筆名單>
	贊助廠商可在會場後擺置一個攤位 (可同時參與多個場次) <因場地限制，名額有限>

附註：本次研討會特別規劃**鑽石級贊助方案**，欲知詳情請科盛科技，將會有專人為您解說。

### ◆ 注意事項：

- 貴公司 Logo 與公司簡介於 6 月 12 日前提提供，簡介字數為 100 字以內。
- 放置於研討會論文集與活動資料袋的文宣請自備，並於 7 月 15 日前寄送至科盛科技，數量請至少準備 1,000 份，尺寸規格為 A4，至多兩張，以單張為主(多頁無法裝定於論文中)。
- 白金級方案將可於會場擺置攤位，展示桌空間大約為 180cm \* 90cm，屆時贊助廠商將可展示公司產品或相關 DM。

貴公司如有意願請填寫下表後，交給與您接洽的業務或回傳科盛科技，感謝配合。

贊助意願表

公司名稱	Core Tech System		
聯絡人		職稱	
電話		傳真	
E-mail			
貴公司願意參加方案	<input type="checkbox"/> 黃金方案(贊助費:NT.\$5,000) <input type="checkbox"/> 白金方案(贊助費:NT.\$20,000)		
是否需要將貴公司提供的 Logo 連結至貴公司網站或公司簡介	<input type="checkbox"/> 需要      網址連結: _____ <input type="checkbox"/> 不需要		
白金級贊助廠商擺設攤位場次(可複選)	<input type="checkbox"/> 台北_8/07(五) <input type="checkbox"/> 新竹_8/12(三) <input type="checkbox"/> 台中_8/13(四) <input type="checkbox"/> 台南_8/14(五)		
備註	Core Tech System		

◆ 附註：

1. 填寫完畢後請回傳科盛科技留存，謝謝您！
2. 贊助費付款方式請洽下方聯絡窗口
3. 聯絡窗口：曾宏志 先生 03-5600199 ext.703
4. E-mail：[henrytseng@moldex3d.com](mailto:henrytseng@moldex3d.com)
5. FAX：03-5600198

崙此敬頌

研 安

 台灣區電腦輔助成型技術交流協會  
**Moldex3D** 科盛科技股份有限公司  
 敬上